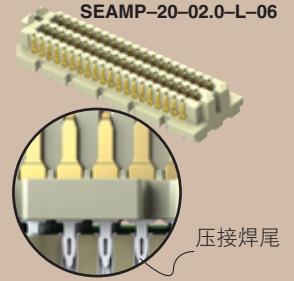


SEAMI-50-11.0-L-10-2-A-K-TR



SEAMP-20-02.0-L-06

压接焊尾

高速/高密度开放式连接器

配接: SEAF, SEAF-RA-GP

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览 www.samtec.com?SEAMP

绝缘体材料: 天然液晶聚合物



触点材料: 铜合金

工作温度范围: -55°C 至 +125°C

电镀: 50μ" (1,27μm) 的镍底上镀金或镀锡

触点电阻: 8.7 mΩ

工作电压: 215 VAC

符合 RoHS 规范要求: 是

加工:

需要应用工具和至少一吨的压力。请联系

ATG@samtec.com 了解更多

信息。

注: 某些尺寸、式样和选项为非标准型, 不可退换。

SEAMP

每排位置数

02.0

电镀选项

排数

选项

SEAMP
= 压接

-10, -20, -30, -40, -50

-L
= 触点区域镀 10μ" (0,25μm) 的金, 焊尾镀雾锡

-04
= 四排
-06
= 六排
-08
= 八排
-10
= 十排

-GP
= 导柱 (仅配接 SEAF-RA-GP)
-TR
= 卷带封装

位置数 x (1,27) .050 + (5,18) .204

位置数 x (1,27) .050

位置数 x (1,27) .050 - (1,27) .050

(1,23) .048

(0,59) .023

(4,60) .181

(1,78) .070

环境温度	SEAMP/SEAF
20°C	2.5A
40°C	2.2A
60°C	1.9A
95°C	1.3A

24 个相邻位置供电

SEAMP 引线式样	SEAF 引线式样		
	-05.0	-06.0	-06.5
-04	(7,06) .278	(2,54) .100	
-06	(9,60) .378	(2,54) .100	
-08	(12,14) .478	(5,08) .200	
-10	(14,68) .578	(7,62) .300	

SEAMP 引线式样	-05.0	-06.0	-06.5
-02.0	7mm	8mm	8.5mm

*加工条件将影响配接高度。

还提供

其他引脚数和电镀选项。请致电 Samtec。

配接: SEAF, SADL

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览 www.samtec.com?SEAMI

绝缘体材料: 黑色液晶聚合物

触点材料: 铜合金

焊接:

95.5% 的锡, 3.8% 的银, 0.7% 的铜 (还提供锡/铅)。

请致电 Samtec.)

工作

温度范围:

测试中!

电镀:

50μ" (1,27μm) 的镍底上镀金或镀锡

触点

电阻:

测试中!

工作电压:

测试中!

符合 RoHS 规范要求:

是可无铅焊接:

是

注: 某些尺寸、式样和选项为非标准型, 不可退换。

SEAMI

每排引脚数

11.0

电镀选项

排数

焊接类型

A

K

TR

SEAMI
= 85Ω 调整

-20,
-30,
-40,
-50

-L
= 触点区域镀 10μ" (0,25μm) 的金, 焊尾镀雾锡

-2
= 无铅焊接

-A
= 定位针
-K
= 聚酰亚胺薄膜取放垫
-TR
= 卷带封装

位置数 x (1,27) .050 + (4,98) .196

位置数 x (1,27) .050

位置数 x (1,27) .050 + (3,58) .141

(14,66) .577

(1,12) .044 直径

(0,86) .034

排数	A	B
-04	(8,33) .328	(2,54) .100
-06	(10,87) .428	(2,54) .100
-08	(13,41) .528	(5,08) .200
-10	(15,95) .628	(7,62) .300

SEAMI 引线式样	SEAF 引线式样			
	-05.0	-06.0	-06.5	-07.5
-11.0	16mm	17mm	17.5mm	18.5mm

*加工条件将影响配接高度。

还提供

其他引脚数和电镀选项。请致电 Samtec。